

AMD GIỚI THIỆU CẤU TRÚC CHIP THẾ HỆ MỚI

Dự án xây dựng cấu trúc chip mới của AMD. (Ảnh: AMD)

Cấu trúc này, được gọi là công nghệ thiết bị xử lý thế hệ mới (Next Generation Processor Technology), sẽ cải tiến thiết kế, nâng cao hiệu suất và

Dự án xây dựng cấu trúc chip mới của AMD. (Ảnh: AMD)

Cấu trúc này, được gọi là công nghệ thiết bị xử lý thế hệ mới (Next Generation Processor Technology), sẽ cải tiến thiết kế, nâng cao hiệu suất và giảm lượng điện tiêu thụ của các dòng chip Opteron, Turion và Athlon 64 hiện nay. "Không chỉ tập trung vào thay đổi thiết kế lõi mỗi năm, chúng tôi hướng đến một chiến lược lớn hơn: khả năng hoạt động tổng thể của hệ thống", Chuck Moore, một lãnh đạo cao cấp của AMD, nhấn mạnh. Thiết bị xử lý dựa trên cấu trúc mới của AMD, dự kiến xuất hiện trong năm 2007, sẽ được trang bị 4 lõi và công nghệ nhập/xuất HyperTransport tốc độ cao. Phiên bản HyperTransport 3.0 mới được hoàn thiện gần đây có thể thực hiện 5,2 tỷ lượt truyền dữ liệu mỗi giây. Một trong những thay đổi lớn nhất là cache - bộ nhớ đệm tích hợp trong thiết bị xử lý để truy cập nhanh dữ liệu. Chip AMD hiện nay có 2 cache/lõi. Trong tương lai, mỗi lõi vẫn có 2 bộ nhớ đệm chuyên dụng nhưng có thể chia sẻ thêm một cache thứ ba để giảm thời gian xử lý thông tin. AMD sử dụng công nghệ chip nhớ DDR2 và DDR3 trong khi Intel lại hướng đến chuẩn FB-DIMM. Tuy nhiên, hãng sản xuất thiết bị xử lý thứ hai thế giới cho rằng công nghệ FB-DIMM sản sinh nhiều nhiệt hơn. Ngược lại, Intel tuyên bố những thiết bị xử lý dành cho máy tính để bàn, thiết bị di động và máy chủ dựa trên cấu trúc chip mới (Core Microarchitecture) là Merom, Conroe và Woodcrest sẽ có hiệu suất cao hơn 20% so với sản phẩm của AMD. Tuy không so sánh từng điểm một, Chuck Moore khẳng định ngay lúc này thiết bị xử lý của AMD đã đủ khả năng để vượt qua đối thủ. "Chỉ cần đối chiếu hiệu suất và lượng điện tiêu thụ, mọi người đã thấy rõ nhiều sự chênh lệch lớn", Moore tuyên bố. P.T.

